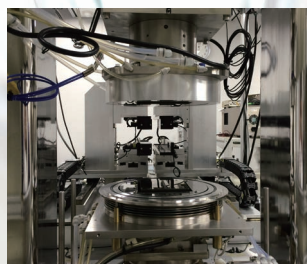


パワーデバイス用Sintering装置(加圧・加熱接合装置) HTM-3000(標準機) HTM-1000(卓上機)

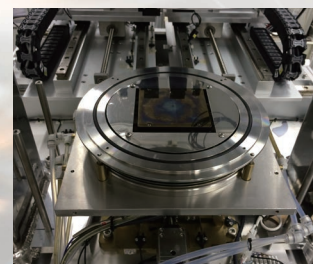


加圧仕様

- 加 圧 力 : 100N~200kN(加圧面積: 100mm×100mm) 標準機
50N~5kN(加圧面積: 40mm×40mm) 卓上機
ロードセルによるクローズド制御
- 加圧精度: ±0.1% 以下(20MPa) 標準機
- 加圧方式: サーボモータ方式、油圧アクチュエータ方式共可能
- サーボモータ方式: 無段階加圧力、加圧速度調整可能
- 油圧アクチュエータ方式: センサーによる多段階加圧制御可能



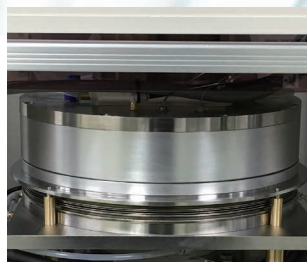
加圧・加熱チャンバー解放時



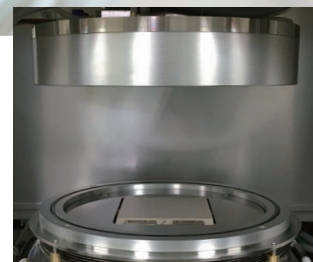
標準金属加圧・加熱ヘッド

加熱・冷却仕様

- 加熱方式: 棒状ヒータ、セラミックヒータ、カセットヒータ
特殊ヒータ等選択可能、Dual加熱機構搭載可能
- 加熱仕様: 1°C/秒 ~ 5°C/秒程度まで多彩に選択可能
(ヒータ及びヘッド部の材質選択による制限有)
- 加熱精度: ±1°C(100°C)、±3°C(300°C ~ 350°C)
- 冷却仕様: 徐冷機能、強制冷却: 空冷、油冷、水冷等選択可能
Dual冷却機構搭載可能
- 環 境: 大気、真空、ガス封入、リフロー状態等選択可能



加圧・加熱チャンバー接合時



最新セラミックヘッド

ワークエリア及びシンタリング方式

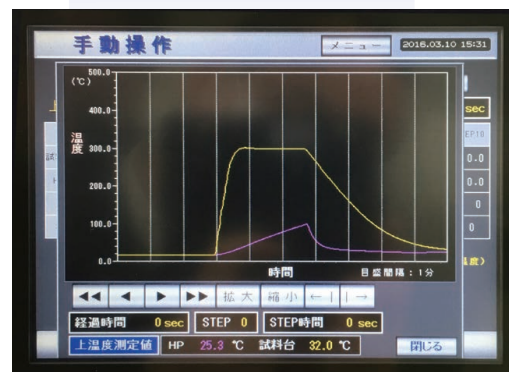
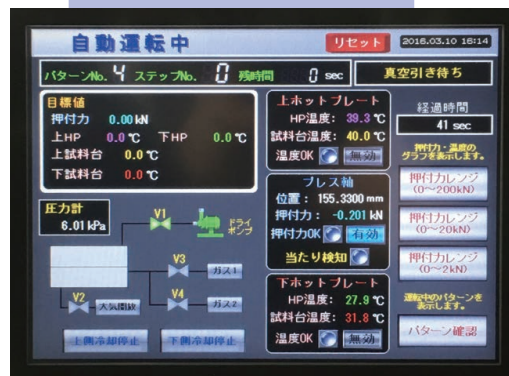
- 標 準 機 : 100mm×100mm ~ 300mm×300mm
卓 上 機 : 40mm×40mm(有効面積30mm×30mm)
- シンタリング方式: 1ヘッド1チップ方式
1ヘッド複数基板一括方式まで可能

その他(デモンストレーション可能)

- 実験用デモンストレーション機保持
デバイス持参での実験可能: お問い合わせください。
- 量産機: 少量多品種型装置から大量生産機まで設計可能
トレイ、チップ搭載機、搬送系等製造ライン全体設計可能
- 装置寸法: 標準機 約1060(W)×1540(D)×2075(H)mm
卓上機 約 360(W)× 400(D)× 780(H)mm

制御画面例

STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP	STEP
押付力(kN)	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
上試料台温度(°C)	130.0	130.0	910.0	910.0	150.0	80.0	0.0
下試料台温度(°C)	1	1	1	1	1	1	0
上HP温度(°C)	80.0	130.0	150.0	150.0	20.0	20.0	0.0
下HP温度(°C)	130.0	130.0	910.0	910.0	150.0	80.0	0.0
下HP温度(°C)	1	1	1	1	1	1	0
下HP温度(°C)	80.0	130.0	150.0	150.0	20.0	20.0	0.0
時間(sec)	50	10	18	180	10	180	0



お問合せ先

伯東株式会社

関西支店 電子機器営業グループ 営業担当 志津野 F1@hakuto.co.jp
〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-6アクロス新大阪5F TEL 06-6350-8913(直)

http://www.hakuto.co.jp